

SEMICON[®] JAPAN

SEMICON JAPAN 2019

参加報告書

群馬大学大学院 理工学府 理工学専攻
電子情報・数理教育プログラム
小林研究室 修士1年 青木里穂

1. イベント名称

SEMICON JAPAN 2019

学会ホームページ

<https://www.semiconjapan.org/jp/>

2. 開催期間

2019年12月11日（水）～12月13日（金）

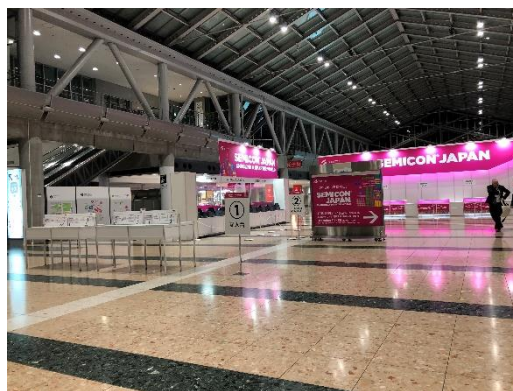
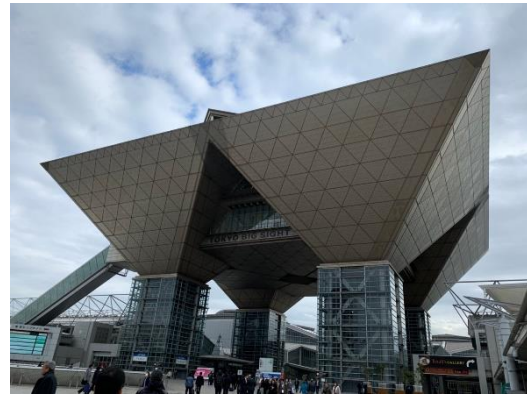
3. 開催地

東京ビッグサイト 西展示棟・南展示棟・会議棟

4. 参加イベント概要

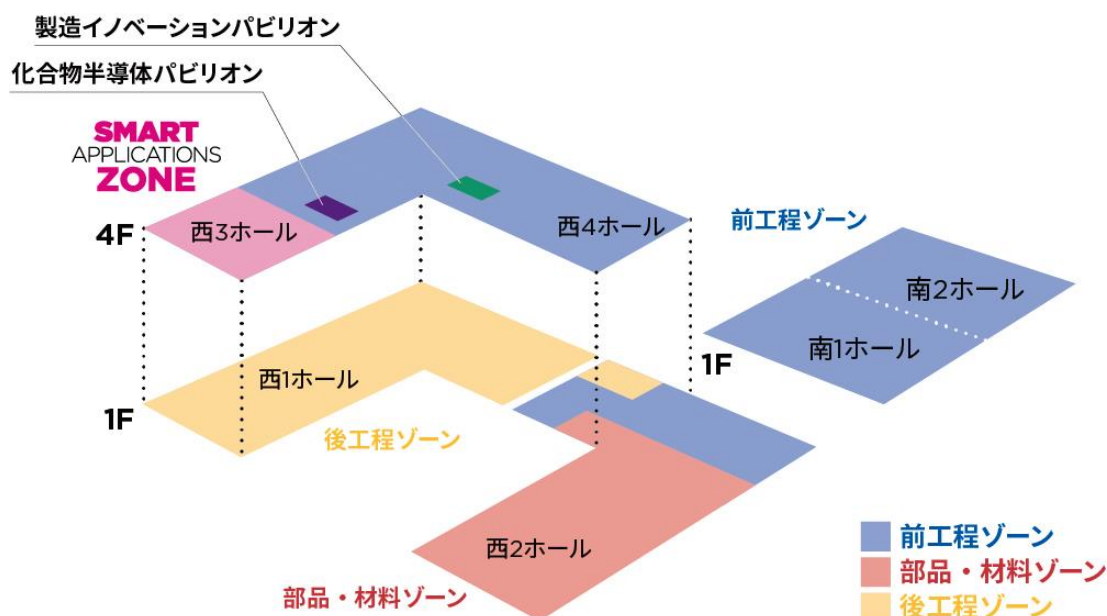
SEMICON Japan は、半導体の前工程～後工程までの全工程から、自動車や IoT 機器などの SMART アプリケーションまでをカバーする、エレクトロニクス製造サプライチェーンの国際展示会である。

今年は約 700 社が最先端の製造技術を展示し、3 日間で延べ 5 万人以上の参加者が国内外から集まった。



5. 参加イベント報告

私は2日目の12月12日（木）に参加し、群馬大学小林春夫研究室ブースでポスター発表を行った。群馬大学の他にも東北や九州など、全国各地から多くの大学が出展していた。企業や学生によるポスター発表の他に、学生向けの「未来 COLLEGE」や「アカデミア」、社会人向けの「TECH CAMP」や「SMART WORKFORCE プログラム」、高専生向けの「THE 高専」なども開催された。未来 COLLEGE では企業ブース訪問の他にも、参加企業の社員の方々と交流できるイベントや、理系学生向けの就職活動セミナーなども開催され、多くの企業について知ることができた。未来 COLLEGE には半導体製造機器などを開発している企業が24社出展しており、私は5社の企業を見学した。B to Bの企業であるためあまり知られていない企業も多かったが、高い技術を持つ優良企業が多く、半導体関係の企業について詳しく知る良い機会となった。企業によっては個別で対応して頂けるところもあり、質問もしやすく、就職活動していく上で貴重な情報が収集できた。その他にも半導体の製造工程を細かく説明して頂けるブースもあり、半導体が完成するまでには何回も多くの工程を繰り返す必要があるということが勉強できた。工程毎に世界トップレベルの技術を持つ企業が多く出展しており、日本企業のレベルの高さを実感した。



6. 謝辞

この度、SEMICON JAPAN 2019 参加の機会を用意し、研究等のご指導頂きました小林春夫先生、参加にあたり様々なサポートをして頂いた桑名杏奈先生、SEMICON JAPANの方々、小林春夫研究室ブースにお立ち寄り頂いた皆様に深く感謝申し上げます。

